

SV-SMT 7.62HP/04/90LF 2.6SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – класс мощности 28 кВА**Точные решения для мощного оборудования**

Большие резервы мощности для увеличения нагрузочной способности:

Устройство среднего класса системы силовых соединительных разъемов OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP благодаря большому диапазону зажимаемых проводов, высокой устойчивости к перегрузкам и широчайшему набору вариантов и аксессуаров является ключевым устройством серии HP. HP значит "High Performance" (высокая мощность), что означает не только максимальный ток без ухудшения характеристик до 50 °C, но и неограниченную сертификацию по UL для 600 В. Кроме того, эти соединительные разъемы согласно стандарту на оборудование IEC61800-5-1 соответствуют требованиям по защите от прикосновения для сетей 400 В TN (+3,0 мм).

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина контактного штифта (l): 2.6 mm, луженые, черный, Ящик
Номер для заказа	2499660000
Тип	SV-SMT 7.62HP/04/90LF 2.6SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118513073
Кол.	50 Шт.
Продуктное отношение	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A
Упаковка	Ящик

SV-SMT 7.62HP/04/90LF 2.6SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота, мин.	11,4 мм	Глубина	28,3 мм
Глубина (дюймов)	1,114 inch	Масса нетто	8,4 g

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	338 мм
VPE с	130 мм	Высота VPE	33 мм

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	7,62 мм
Шаг в дюймах (P)	0,3 inch	Угол вывода	90°
Количество полюсов	4	Количество контактных штырьков на полюс	2
Длина контактного штифта (l)	2,6 мм	Допуск на длину выводов под пайку	+0,1 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку	0,8 x 1,0 mm	Диаметр монтажного отверстия (D)	1,4 мм
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)	+ 0,1 мм	L1 в мм	22,86 мм
L1 в дюймах	0,9 inch	Количество рядов	1
Количество полюсных рядов	1	Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106	safe to back of hand above the printed circuit board
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470	IP 20	Объемное сопротивление	2,00 МОм
Циклы коммутации	25	Усилия вставки на полюс, макс.	12 N
Усилия вытягивания на полюс, макс.	7 N		

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA GF HT3	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	I
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 600	Прочность изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	3	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал контакта	Медный сплав	Поверхность контакта	луженые
Структура слоев соединения под пайку	1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn матовый	Структура слоев штепсельного контакта	1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn матовый
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	130 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	130 °C

SV-SMT 7.62HP/04/90LF 2.6SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту

IEC 60664-1, IEC 61984

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)

41 A

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)

41 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2

630 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2

6 kV

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3

6 kV

Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)

41 A

Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)

41 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2

1 000 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3

630 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2

6 kV

Устойчивость к воздействию кратковременного тока

3 x 1 сек. с 420 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)

300 V

Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)

300 V

Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)

40,5 A

Разделительное расстояние, мин.

6,9 мм

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059)

300 V

Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)

40,5 A

Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)

10 A

Расстояние утечки, мин.

9,6 мм

Классификации

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

Важное примечание

Соответствие IPC

Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Примечания

- Дополнительные цвета — по запросу
- Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
- Р на чертеже – шаг
- Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
- Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

SV-SMT 7.62HP/04/90LF 2.6SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search

E60693

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

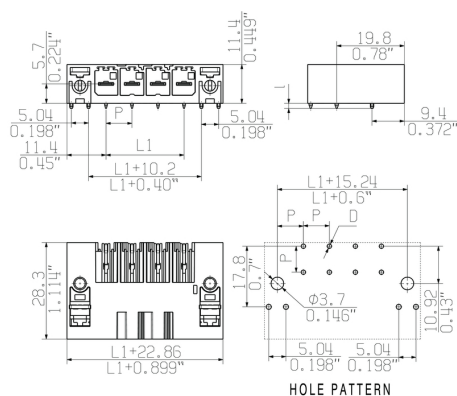
SV-SMT 7.62HP/04/90LF 2.6SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

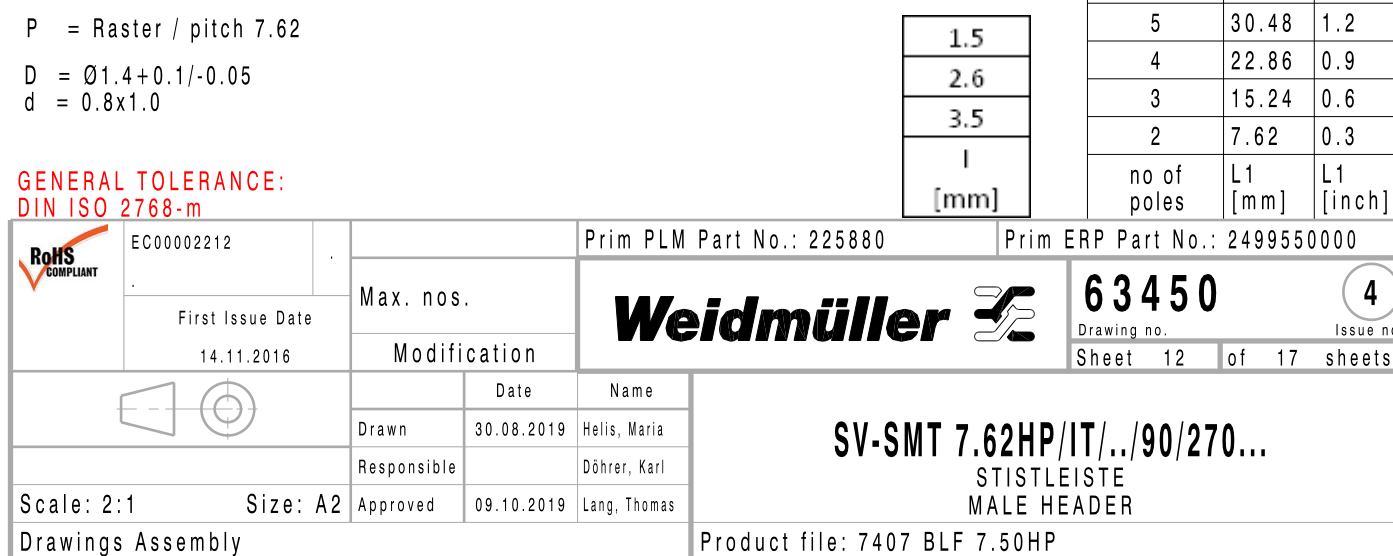
www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Lötstifte nur für MLF-Varianten
Soldering pins only for MLF-variants



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.